



低反り(～230℃)

【従来材料】

金属、他熱可塑性樹脂 (PEEK、PES)

【問題点】

金属：金属ゴミ (ICチップへの影響)

樹脂：成形品寸法精度 (反り)

【要求特性】

低そり、帯電防止性 ($10^6 \sim 10^{10} \Omega$)

オーラム®での優位性

- ・ 成形品精度 (低反り)
- ・ 低発塵性

高温環境下でも成形品精度を維持 (反り)

 推奨銘柄：JCF3025